

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2024-045

江苏艾森半导体材料股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,068,631 股。

本次股票上市流通总数为 1,068,631 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 6 日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062 号）同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266 号”批准，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,033,334 股，并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行后公司总股本为 88,133,334 股，其中有限售条件流通股 71,502,547 股，占公司总股本的 81.13%，无限售条件流通股 16,630,787 股，占公司总股本的 18.87%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 7,857 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,068,631 股，占公司股本总数的 1.21%。具体详见公司于 2023 年 11 月 29 日和 2023 年 12 月 1 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》和《江苏艾森半导体

材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 1,068,631 股，现锁定期即将届满，将于 2024 年 6 月 6 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：

截至本核查意见出具日，公司首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次网下配售限售股份上市流通数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求。公司对本次网下配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,068,631 股，占公司目前股份总数的比例为 1.21%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 6 月 6 日。

(三) 限售股上市流通清单如下:

单位: 股

序号	限售股类型	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	首次公开发行网下配售限售股	1,068,631	1.21%	1,068,631	0
合计		1,068,631	1.21%	1,068,631	0

注: 1、持有限售股占公司股本比例以四舍五入的方式保留两位小数;

2、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股, 限售股股东数量为7,857名, 详见公司2023年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

(四) 限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量	限售期
1	首发限售股	1,068,631	6个月
合计	-	1,068,631	-

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年5月29日